



领格新材料 渠道合作说明

给渠道伙伴的入门说明

电子胶粘剂和定制材料，用白话讲清楚

2026.10



Q&A（快速问答）

Q：领格做什么？ A：一句话：给电子产品做“专用胶”和配套材料。

Q：电子胶是什么？ A：电子胶，就是用来粘接、保护、导电或散热，帮助电子产品稳定工作的功能性胶粘材料。

客户可能遇到的问题

粘不牢、怕水、散热差、固化慢

01 找准行业

找到对口客户，对口应用，我们负责确定体系。

02 把问题说清楚

先看客户的材料、设备、温度、速度和可靠性要求。

03 选产品或调配方

有现成产品就快速选型，需求特殊就按项目调整。

04 陪客户导入量产

送样、测试、现场调试和稳定供货，由同一团队跟进。



渠道商交给客户的是一套能落地的材料方案

优先开拓的六类行业

按 2026 年增长空间、用胶强度和领格现有产品匹配度排序

01 半导体封装与 AI 算力设备

底部填充、导电粘接、散热和保护

02 光通信与数据中心

精密定位、低收缩、耐湿热和光学粘接

03 新能源汽车与智能驾驶

电池、电控、摄像头、雷达和热管理

04 电机、机器人与户外设备

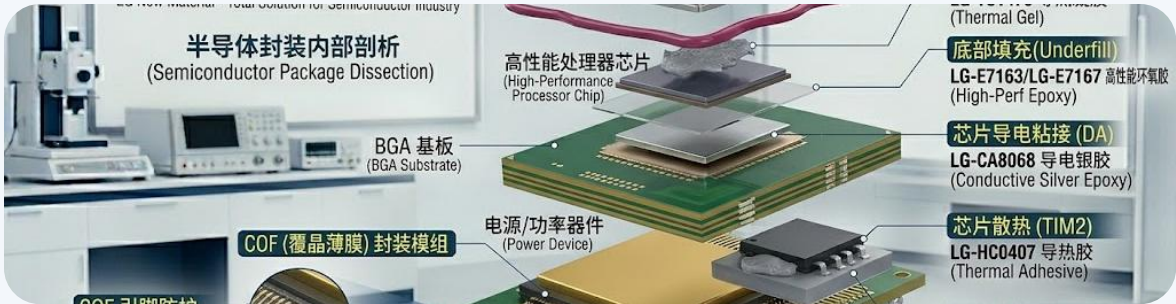
耐高温、抗振动、密封和深层固化

05 声学与可穿戴

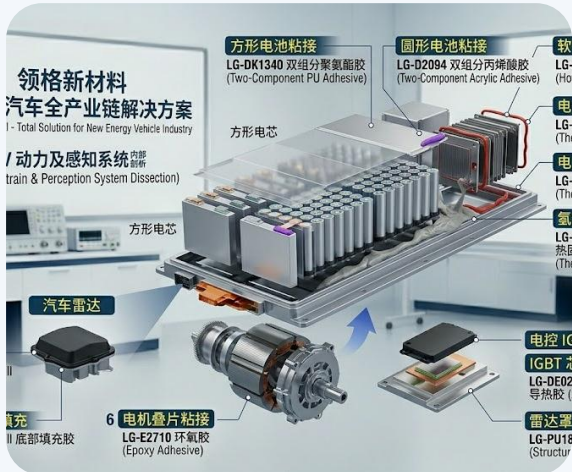
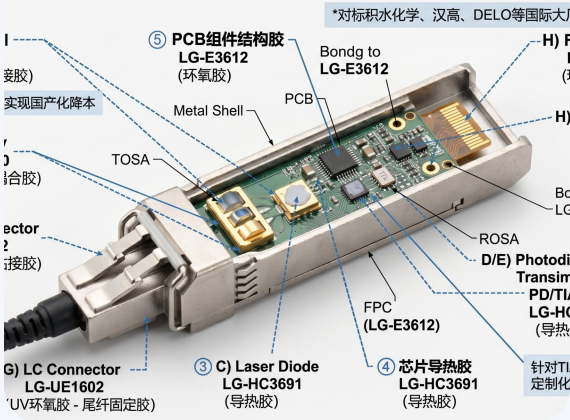
难粘材质、耐汗液、防水和低 VOC

06 手机、FPC 与显示模组

窄边框、跌落、防水和柔性保护



光模块组件专用胶应用标注 (LG系列牌号对照)



这是渠道优先级建议，不是市场规模排名

创始人与研发底牌

04

不用先成为材料专家，领格研发团队会一起拆解客户问题

张辉博士 创始人 / 研发负责人

教育经历

大连理工大学高分子材料，英语双学位
中国科学院国家纳米科学中心材料学工学博士

从业经历

参与航天特种耐高温透波陶瓷复合材料项目
2014-2019 任汉高 Ablestik、LOCTITE 产品开发科学家

服务 Apple、Samsung、Huawei、Xiaomi 等国际客户
的结构胶与封装材料开发

2023 年创立领格新材料，聚焦半导体先进封装与高端
电子材料国产替代

材料学博士，长期从事高分子材料、纳米复合材料和电
子胶粘剂研发。

20+ 发明专利经历 **6 篇 SCI**



技术能力怎么变成客户价值

从树脂结构、填料和固化方式入手，解决根本参数匹配。

客户需要低收缩、快固化、耐温、导电或散热，团队都能围绕
实际工艺做匹配。

领格的五个优势

渠道伙伴可以直接用这五点回答客户的常见问题

- | | | |
|----|--------------|-----------------------------|
| 01 | 技术替代 | 围绕性能、工艺和可靠性匹配进口材料，减少客户切换风险。 |
| 02 | 针对开发 | 粘度、固化速度、耐温或强度有特殊要求，可以按项目调整。 |
| 03 | 价格更灵活 | 本地研发与生产，减少进口溢价，起订量和交付方式更好谈。 |
| 04 | 响应更直接 | 需求、样品、测试和现场调试由同一团队持续跟进。 |
| 05 | 售后能落地 | 从打样到量产都有人负责，出现问题可以快速复盘和改进。 |



渠道合作为什么值得长期做

领格负责技术和交付，渠道伙伴负责找到场景、连接客户、推动验证

验证通过后

客户复购通常更稳定

从一个用胶点开始

可扩展到更多型号和产品线

增长行业不断出新项目

AI、光通信、汽车电子带来持续机会

一个项目怎样走到订单



适合的渠道伙伴

有电子制造客户资源，愿意一起跟进测试、验证和量产项目

sales@molelinker.com www.molelinker.com

期待与您一起做长期项目

以下为部分测试通过企业与合作企业

